

2019年中国IC先进封装市场分析报告- 行业竞争格局与前景评估预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国IC先进封装市场分析报告-行业竞争格局与前景评估预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/400459400459.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章IC封装产业相关概述

第一节IC封装涵盖

第二节IC封装类型阐述

一、SOP封装

二、QFP与LQFP封装

三、FBGA

四、TEBGA

五、FC-BGA

六、WLCSP

第三节明日之星——TSV封装

一、TSV简介

二、TSV与SoC

三、TSV产业与市场

第二章世界IC封装产业运行态势分析

第一节世界IC封装业运行环境浅析

一、全球经济大环境及影响分析

二、全球集成电路产业运行总况

第二节世界IC封装运行现状综述分析

一、IC封装产业热点聚焦

二、IC封装业新技术应用情况

三、全球IC封装基板市场调研

四、全球IC封装材料市场发展

五、全球IC封装生产企业向中国转移

第三节世界IC封装重点企业运行分析

一、英特尔（Intel）

二、IBM

三、超微

四、英飞凌（Infineon）

第四节世界IC封装业趋势探析

第三章2015-2018年中国IC封装行业市场运行环境解析

第一节2015-2018年中国宏观经济环境分析

- 一、国民经济增长
- 二、中国居民消费价格指数
- 三、工业生产运行情况
- 四、房地产业投资情况
- 五、中国制造业采购经理指数

第二节2015-2018年中国IC封装市场政策环境分析

- 一、电子产业振兴规划解读
- 二、IC封装标准
- 三、内需拉动产业，IC业政策与整合是关键
- 四、相关行业政策及对IC封装产业的影响

第三节2015-2018年中国IC封装市场技术环境分析

- 一、高端IC封装技术
- 二、中高端IC封装技术有所突破
- 三、IC封装基板技术分析

第四章2015-2018年中国IC封装产业整体运行新形势透析

第一节2015-2018年中国IC封装产业动态聚焦

- 一、半导体封装基板项目落户无锡
- 二、国内IC封装及IC基板用硅微粉实施产业化
- 三、中国IC代工封装等已进入国际排行榜

第二节2015-2018年中国IC封装产业现状综述

- 一、我国IC封装业正向中高端迈进
- 二、探密中国IC封装产业变局
- 三、中国正成为全球IC封装中心
- 四、IC封装年产能分析

第三节2015-2018年中国IC封装产业差距分析

- 一、工艺技术
- 二、质量管理
- 三、成本控制

第四节2015-2018年中国IC封装产业思考

- 一、技术上：引进和创新相结合
- 二、人才上：引进和培养相结合
- 三、资金上：资本运作是主要途径

第五章2015-2018年中国IC封装技术研究

第一节2015-2018年中国IC封装技术热点聚焦

- 一、封装测试技术新革命来临
- 二、芯片封装厂封装技术或转向铜键合
- 三、RFID电子标签的封装形式和封装工艺
- 四、降低封装成本提升工艺水平措施

第二节高端IC封装技术

- 一、IC制造技术
- 二、TABPottingSystem
- 三、BGA,CSPBallMountingSystem
- 四、Flip-ChipBondingSystem
- 五、TABMarkingSystem
- 六、TFT-LCDCellBondingSystem

第六章2015-2018年中国IC封装测试领域深度剖析

第一节2015-2018年中国IC封装测试业运行总况

- 一、IC封装测试业外资独占鳌头
- 二、测试企业布局力度将加大
- 三、中高档封测产品占比将逐年提升
- 四、应对知识产权、环保考验

第二节新型封装测试技术

- 一、MCM(MCP)技术
- 二、SiP封装测试技术
- 三、MEMS技术
- 四、BCC封装技术
- 五、FlashMemory(TSOP)塑封技术
- 六、多种无铅化塑封技术
- 七、汽车电子电路封装测试技术
- 八、StripTest(条式/框架测试)技术
- 九、铜线键合技术

第七章2015-2018年中国IC封装产业主要数据监测分析（4053）

第一节2015-2018年份中国IC封装行业规模分析

- 一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

四、销售规模增长分析

第二节2015-2018年中国IC封装行业应收账款情况分析

第三节2015-2018年中国IC封装行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

第四节2015-2018年中国IC封装行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

第五节2015-2018年中国IC封装行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第八章2015-2018年中国IC封装产业运行新形势透析

第一节2015-2018年中国IC封装产业运行综述

一、大陆IC封装企业的分布及其特点

二、IC封装向高端技术迈一步

三、形成封装及自主品牌终端产业链

第二节2015-2018年中国IC封装产业变局分析

一、IC封装业稳步发展，但产值比重有所下降

二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈

三、封装技术更新加快，国内水平显著提高

第三节金融危机对中国IC封装业影响及应对分析

一、金融危机对封装业冲击较大

二、创新使IC封装企业成功渡过危机

第四节2015-2018年中国IC封装业面临的挑战分析

一、低档产品封装产能过剩,高端产品的封装刚刚起步

二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战

三、我国IC的相关行业配套能力差,也对封装业造成不利影响

四、技术相对滞后

五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足

第五节对发展我国IC封装业的思考

第九章2015-2018年中国IC封装细分市场运行分析

第一节手机IC封装市场

第二节手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

第三节智能手机处理器产业与封装

第四节手机射频IC

一、手机射频IC市场

二、手机射频IC产业

三、4G时代手机射频IC封装

第五节PC领域先进封装

一、DRAM产业近况

二、DRAM封装

三、NAND闪存产业现状

四、NAND闪存封装发展

五、CPU/GPU和南北桥芯片组

第十章2015-2018年中国封装用材料运行分析

第一节金线

第二节IC载板

第十一章2015-2018年中国IC封装产业竞争新格局探析

第一节2015-2018年中国IC封装竞争总况

一、封装市场竞争激烈

二、倒装芯片封装更具竞争力

三、封装低端市场竞争力加强

四、IC封装技术竞争力分析

五、外资加大中国市场布局对产业竞争的影响

第二节2015-2018年中国IC封装产业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业集中度分析

第三节2019-2025年中国IC封装竞争趋势分析

第十二章中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

第一节长电科技（600584）

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节深圳赛意法微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节南通富士通微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节英特尔产品(成都)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节无锡菱光科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节恒宝股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节南京汉德森科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节深圳市比亚迪微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节常州市欧密格电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十三章中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

第一节安靠封装测试(上海)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第二节沛顿科技(深圳)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第三节淄博凯胜电子技术有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节河南鼎润科技实业有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第五节盟事达智能卡技术(深圳)有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第十四章中国封装材料企业运营竞争性指标分析

第一节汉高华威电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第二节厦门惠利泰化工有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第三节福建易而美光电材料有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节无锡创达电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第五节鼎贞(厦门)系统集成有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节无锡市江达精细化工有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节陕西华电材料总公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节无锡嘉联电子材料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十五章2019-2025年中国IC封装业趋势分析

第一节2019-2025年中国IC封装业趋势分析

一、环氧树脂在电子封装应用方面前景开阔

二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明

第二节2019-2025年中国IC封装产业新趋势探析

一、新型的封装发展趋势

二、集成电路封装的发展趋势

三、IC封装技术发展趋势

四、IC封装材料市场发展趋势

五、半导体IC封装技术发展方向

第三节2019-2025年中国IC封装市场趋势分析

第四节2019-2025年中国IC封装市场盈利预测

第十六章2019-2025年中国IC封装行业发展预测及风险分析

第一节2019-2025年中国IC封装行业供需预测

一、市场规模预测

二、生产预测

三、需求量预测

第二节2019-2025年中国IC封装行业投资机会分析

第三节2019-2025年中国IC封装行业风险分析

一、市场供需风险

二、经营管理风险

三、政策风险

四、其它风险

第四节2019-2025年中国IC封装行业投资前景及策略建议

一、对行业发展形势的总体判断

二、投资前景及市场策略分析

图表目录：

图表：2015-2018年中国IC封装产业企业数量及增长率分析单位：个

图表：2015-2018年中国IC封装产业亏损企业数量及增长率分析单位：个

图表：2015-2018年中国IC封装产业从业人数及同比增长分析单位：个

图表：2015-2018年中国IC封装企业总资产分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装产成品及增长分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装工业销售产值分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装出口交货值分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装行业销售成本分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装行业费用分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装行业主要盈利指标分析单位：亿元

图表：2015-2018年中国IC封装行业主要盈利能力指标分析

图表详见报告正文.....（css）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提

供商与综合行业信息门户。《2019年中国IC先进封装市场分析报告-行业竞争格局与前景评估预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/400459400459.html>